

低融点ソルダペースト

Low temperature solder paste

SB58-COSMO-NH-T4

SB35-COSMO-NH-T4

低融点組成で常温輸送、常温保管が可能

Low temperature solder paste to enable room temperature transport and storage

ROLO 対応品

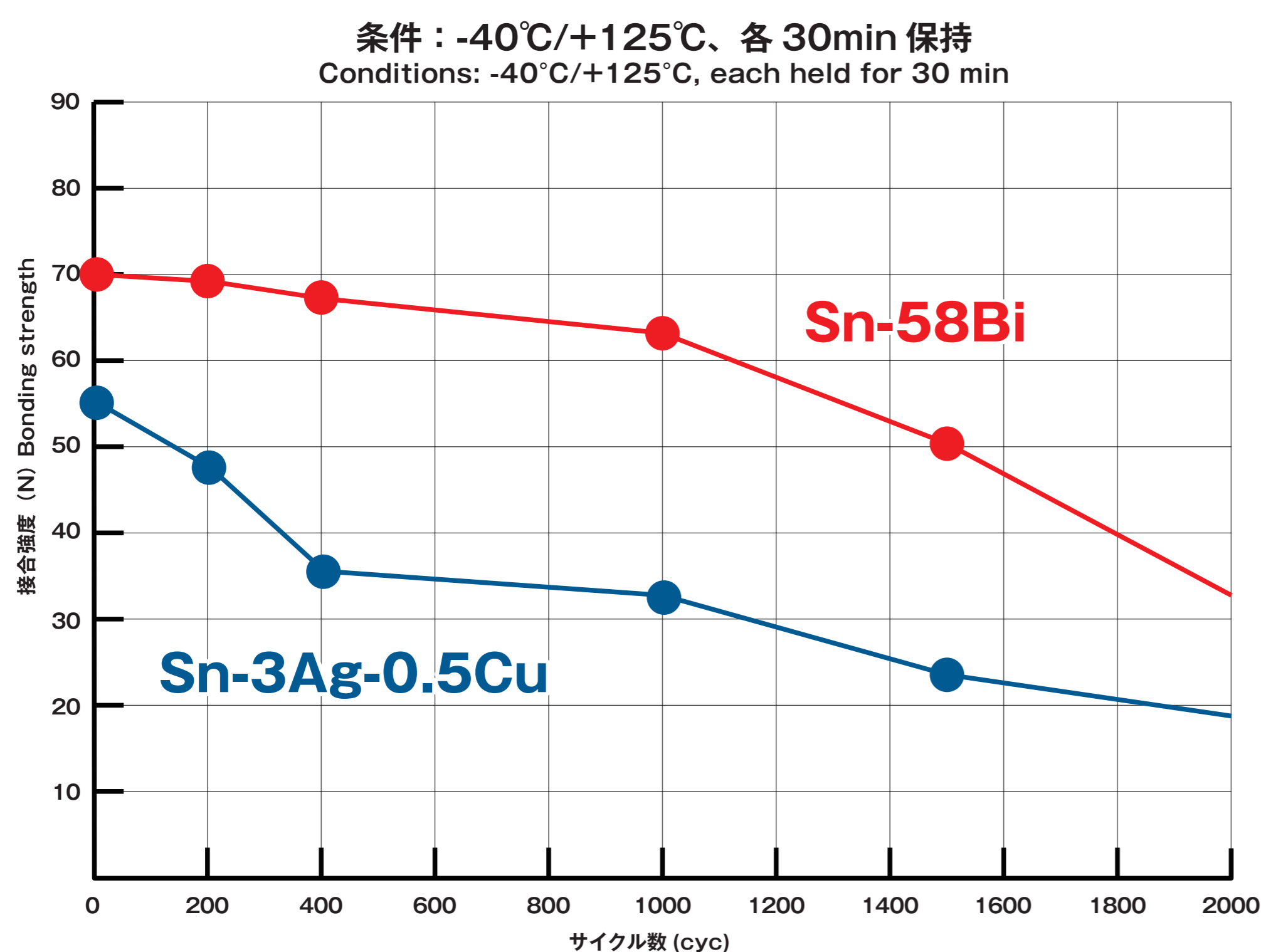
ROLO support

Sn-58Bi 組成と Sn-35Bi 組成の 2 種類用意

Two types of Sn-58Bi and Sn-35Bi compositions are available

熱衝撃試験比較

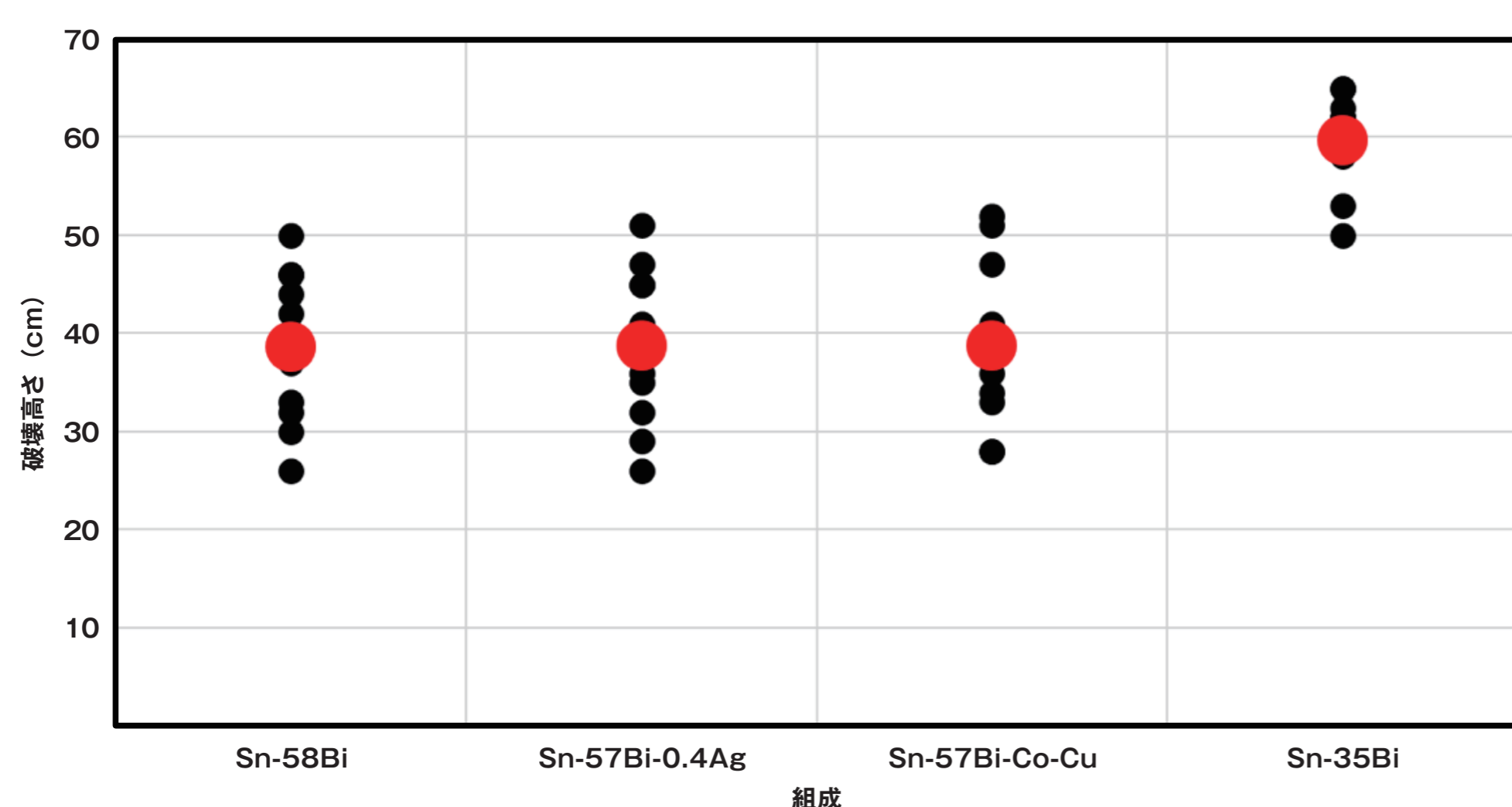
Thermal Shock Test Comparison



熱衝撃による劣化度合は Sn-3Ag-0.5Cu と比較して同等以上
Degradation by thermal shock is equal to or greater than that of Sn-3Ag-0.5Cu

落下衝撃試験比較

Comparison at drop impact test



Sn-58Bi と比較して Sn-35Bi は耐衝撃性が 54.7% 向上
Sn-35Bi has 54.7% higher impact resistance than Sn-58Bi

※ただし、リフロープロファイルの本加熱温度は 190°C 迄上げる必要が御座います。
融点 Sn-58Bi: 139°C、Sn-35Bi: 138~187°C
However, Reflow peak in the reflow profile must be increased to 190°C.
Melting point Sn-58Bi: 139°C, Sn-35Bi: 138-187°C

SB58-DPS101-T4

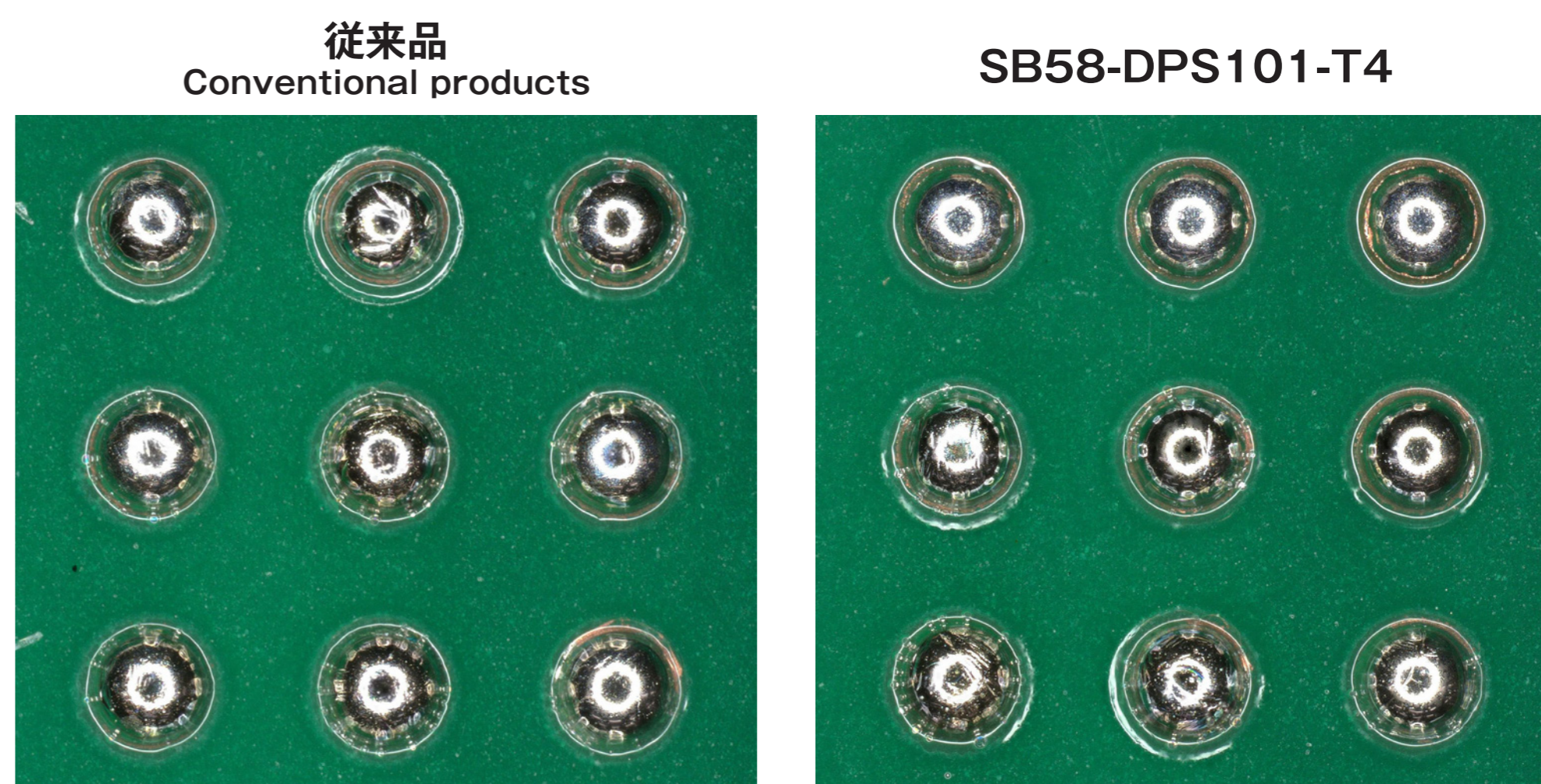
優れた凝集力によりレーザーはんだ付けでも飛散を低減
Excellent cohesion reduces splattering even with laser soldering methods

エリアレーザー工法にも対応
Applicable for heating by area-laser

溶融性比較 (レーザーはんだ付け工法)

Comparison of melting performance (laser soldering method)

基板: BGAφ0.5mm Substrate: BGA φ0.5mm
出力: 5W Output: 5W
時間: 3sec Time: 3sec



溶融性が良く、飛散も少ない
Good melting properties and less scattering

低融点ペーストラインナップ一覧

Low temperature solder paste lineup list

品名 Product code	金属組成 Solder composition	粉末粒径 Particle size (μm)	特長 Features
SB58-COSMO-NH-T4	Sn-58Bi	TYPE4 : 38-22	印刷用常温保管可能タイプ Keeping at the normal temperature is possible.
SB35-COSMO-NH-T4	Sn-35Bi	TYPE4 : 38-22	印刷用常温保管可能タイプ (リフローピーク温度 190°C 対応) Keeping at the normal temperature is possible. (Supports reflow peak temperature of 190°C)
SB58-DPS101-T4	Sn-58Bi	TYPE4 : 38-22	レーザー対応 (ディスペンス対応、TYPE5 も対応可能) Laser compatible (printing and dispensing available, TYPE5 is also available)
SB58-EPP101-T4	Sn-58Bi	TYPE4 : 38-22	エポキシ樹脂系ペースト (印刷用、TYPE5 も対応可能) Epoxy resin-based solder paste (For printing, TYPE5 is also available)
SB58-EPC101-T4	Sn-58Bi	TYPE4 : 38-22	エポキシ樹脂系ペースト (ディスペンス用、TYPE5 も対応可能) Epoxy resin-based solder paste (For dispensing, TYPE5 is also available)
SB58-ACP-T6	Sn-58Bi	TYPE6 : 15-5	導電性接着剤に代わるエポキシ樹脂系ペースト (加圧加熱方式対応) Epoxy resin-based solder paste with low melting temperature as an alternative to conductive adhesives (Applicable for soldering with pressing by heating tool)
SB58-ACS-T6	Sn-58Bi	TYPE6 : 15-5	導電性接着剤に代わるエポキシ樹脂系ペースト (リフロー・オープン方式対応) Epoxy resin-based solder paste with low melting temperature as an alternative to conductive adhesives (Applicable for soldering by reflow oven)
SB6-HLGQ-20	Sn-57Bi-0.4Ag	TYPE4 : 38-22	10 年の使用実績有り 10 years in use
winDot-SB58-T6	Sn-58Bi	TYPE6 : 15-5	ジェットディスペンス対応ペースト (φ160μm 塗布可能) Paste for jet dispensing (φ160μm dispensable)

